

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年6月17日(2010.6.17)

【公開番号】特開2009-26959(P2009-26959A)

【公開日】平成21年2月5日(2009.2.5)

【年通号数】公開・登録公報2009-005

【出願番号】特願2007-188630(P2007-188630)

【国際特許分類】

H 01 L 21/60 (2006.01)

H 05 K 3/34 (2006.01)

H 01 L 23/12 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/92 604H

H 05 K 3/34 505A

H 05 K 3/34 505B

H 01 L 23/12 501Z

【手続補正書】

【提出日】平成22年4月28日(2010.4.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上の複数の接続パッド上に各1個の導電性ボールを搭載する方法であって、

導電性ボールの搭載位置に導電性ボール受容口を有する位置決め層と支持層とが積層して成る導電性ボール仮配置板であって、該支持層は少なくとも該位置決め層の導電性ボール受容口の部位では下記フラックスを透過可能である導電性ボール仮配置板を用い、

導電性ボールをフラックス中に分散させたペーストを、上記導電性ボール仮配置板の位置決め層側から刷り込んで、各導電性ボール受容口内に各1個の導電性ボールを含むペーストを保持させ、

上記導電性ボール仮配置板の導電性ボール受容口を上記基板の接続パッドに位置合わせて、各導電性ボール受容口内に保持されたペーストを各接続パッドに転写することにより、接続パッド上にフラックスを伴った導電性ボールを搭載することを特徴とする導電性ボールの搭載方法。

【請求項2】

請求項1において、前記支持層の裏面側に前記フラックスの吸収層を密着配置した状態で、前記位置決め層側から前記ペーストを刷り込むことを特徴とする導電性ボールの搭載方法。

【請求項3】

請求項1または2において、前記支持層が、前記位置決め層の導電性ボール受容口の部位に、前記フラックスが透過する貫通孔を備えていることを特徴とする導電性ボールの搭載方法。

【請求項4】

請求項1または2において、前記支持層が、前記フラックスが透過するメッシュから成ることを特徴とする導電性ボールの搭載方法。

【請求項5】

請求項 1 から 4 までのいずれか 1 項において、前記ペーストの前記導電性ボール仮配置板への刷り込みを、前記位置決め層上でのスキージ操作により行なうことを特徴とする導電性ボールの搭載方法。

【請求項 6】

請求項 1 から 4 までのいずれか 1 項において、前記ペーストの前記導電性ボール仮配置板への刷り込みを、前記位置決め層上でのピストン加圧により行なうことを特徴とする導電性ボールの搭載方法。

【請求項 7】

請求項 1 から 6 までのいずれか 1 項において、前記導電性ボール仮配置板の導電性ボール受容口から前記基板の接続パッドへの前記ペーストの転写を、押圧子による押圧によって行なうことを特徴とする導電性ボールの搭載方法。

【請求項 8】

請求項 1 から 6 までのいずれか 1 項において、前記導電性ボール仮配置板の導電性ボール受容口から前記基板の接続パッドへの前記ペーストの転写を、前記支持層の裏面側からの気体の噴射によって行なうことを特徴とする導電性ボールの搭載方法。